

2017

Technology Seminar

TRI innovation

Inspection and Testing for the Smart Factory

迎接智能工厂的到来

日期..... 时间.....

01 MAR 9:00AM
2017 16:00PM

地点.....
Shangri-la Hotel Shenzhen
深圳香格里拉大酒店

时程

- 9:20~9:40** 报到
报到与早餐

- 10:00~10:10** 开场
林总 开场及前言

- 10:10~10:50** 3D SPI
高速及自动化3D SPI

- 10:50~11:40** 3D AOI
超精准3D 爬锡与焊点检测

- 11:40~12:00** 产品展示
现场产品展示

- 12:00~13:30** 午餐
用餐, 沟通及交流

- 13:30~14:20** AXI, CT 检测
革命性断层扫描(CT)应用与 NPI Solutions

- 14:20~15:00** Multi-core ICT Testing
新型多核心TR5001D SII INLINE ICT

- 15:00~15:30** YMS 4.0 生产良率管理系统

- 15:30~16:00** 茶歇+产品展示

- 16:00** Q&A, 有奖徵答

新产品介绍



TR7007Q 3D SPI

智能型走停式3D SPI, 拥有高速 CoaXPress取像及四向数位条纹光投影, 最高解析度可达6μm, 适合 0250125 mm微小元件检测。



TR7700QE 3D AOI

精准型走停式3D AOI, 拥有四向数位条纹光投影及高速CoaXPress取像, 最高解析度可达10μm, 可检测锡点的爬锡品质及高度。



TR7600 SIII AXI

全新3D X射线检测系统拥有超高速线性相机及高解析的断层数位扫描(CT), 可检测复杂的多层板及隐藏式锡点。



TR5001D SII INLINE ICT

新型双核心平行测试的在线性ICT检测方案, 提升检测精准度、速度、产能及减低人力需求。

若有任何问题请联系:

毛来黎 小姐 Tel: +86-755-8311-2668 分机 6033, 或 email: Laili_Mao@cn.tri.com.tw

<http://marketing.tri.com.tw/2017seminar/sz.aspx>

诚邀参加!

在线报名请按此

德律® TRI INNOVATION®

